证券代码：688693　　证券简称：锴威特　　公告编号：2026-052

苏州锴威特半导体股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买晶艺半导体有限公司 100%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 8 月 26 日收到上海证券交易所出具的《关于受理苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2026〕37 号），并于 2026 年 9 月 8 日收到上海证券交易所出具的《关于苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2026〕42 号）。

根据上海证券交易所的审核意见，公司会同各中介机构就相关问题进行了逐项核实、落实和回复，同时，本次交易的审计基准日更新至 2026 年 6 月 30 日，公司对《苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）》进行了修订、补充和完善，并于同日披露了《苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关文件。

相较公司于 2026 年 8 月 26 日披露的《苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）》，本次主要修订情况如下：

重组报告书章节	修订说明
释义	更新释义。
重大事项提示	更新了加期财务数据、本次交易的决策程序等相关内容。
重大风险提示	更新加期财务数据相关内容，新增标的公司大额股份支付的风险。
第一章 本次交易概况	更新本次交易的决策程序。
第二章 上市公司基本情况	1、更新了上市公司截至 2026 年 9 月 30 日的前十大股东情况； 2、更新了加期财务数据。
第三章 交易对方基本情况	更新交易对方基本情况。
第四章 交易标的基本情况	1、更新标的公司历史沿革； 2、根据加期后情况，更新相关内容。
第五章 发行股份情况	更新加期后本次募集配套资金的必要性。
第九章 管理层讨论与分析	更新了加期财务数据。
第十章 财务会计信息	更新了加期财务数据。
第十一章 同业竞争和关联交易	根据加期审计情况，更新相关内容。
第十二章 风险因素分析	更新加期财务数据相关内容，新增标的公司大额股份支付的风险。
第十四章 对本次交易的结论性意见	更新了独立董事意见等内容。
附件 交易对方穿透核查情况	更新截至 2026 年 10 月末的最新情况。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日